附件1

名词解释

| 名词 | 释义 |
| --- | --- |
| Full Mask | 全掩膜，制造流程中的全部掩膜都为某个设计服务。 |
| MPW | 多项目晶圆，即多个项目共享某个晶圆，也即同一次制造流程可以承担多个集成电路（IC）设计的制造任务。 |
| EDA | 全称电子设计自动化工具（Electronic Design Automation），是半导体行业必备的设计工具软件，是从计算机辅助设计、计算机辅助制造、计算机辅助测试和计算机辅助工程的概念发展而来的。以计算机为工具，设计者在 EDA 软件平台上，将芯片从电路设计、性能分析到设计出 IC 版图的整个过程都交由计算机自动处理完成。 |
| IP | 全称知识产权核（intellectual property core），是在集成电路的可重用设计方法学中，指某一方提供的、形式为逻辑单元、芯片设计的可重用模组。 |
| AEC-Q100 | 汽车集成电路的重要应力测试标准。由AIAG汽车组织开发的用于集成电路的资格认证测试流程。 |
| AEC-Q101 | 车用分立半导体元器件的基于失效机理的应力测试验证。 |
| AEC-Q200 | 针对汽车上应用的被动元器件的产品标准。 |
| ISO/TS 16949 | 又名IATF16949，全称“质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9007的要求”，IATF16949是国际汽车行业的技术规范，是基于ISO9001的基础，加进了汽车行业的技术规范。此规范完全和ISO9001：2015保持一致，但更重于缺陷防范，减少在汽车零部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。 |
| 流片 | 指像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，在集成电路设计领域特指“试生产”。 |